# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

TE

(11) Publication number:

11-001387

(43) Date of publication of application: 06.01.1999

(51)Int.CI.

C30B 7/10 C30B 29/32 H01L 41/09 H01L 41/24

(21)Application number: 09-155109 (71)Applicant: FUKUDA TOSHIO

**ARAI FUMITO** 

TOKAI RIKA CO LTD

(22)Date of filing:

12.06.1997

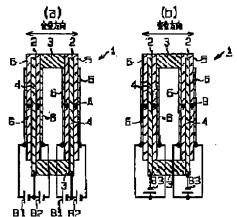
(72)Inventor: FUKUDA TOSHIO

**ARAI FUMITO** ITOIGAWA KOICHI **IWATA HITOSHI** 

(54) PZT THIN FILM BIMORPH STRUCTURE, PARALLEL FLAT PLATE STRUCTURE OF PZT THIN FILM BIMORPH SHAPE AND ITS PRODUCTION (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a PZT thin film bimorph structure capable of readily providing a great number of bimorph structures and being miniaturized.

SOLUTION: This parallel flat plate structure 1 is constituted by mutually opposing a pair of piezoelectric elements 2 made of a bimorph structure and laying prismatic insulating spacers 3 between both ends of the upper and lower parts and sticking the spacers to the ends. The piczoclectric elements 2 made of the bimorph structure are provided with PZT thin films 5 having tens um thickness on both the surface and back sides of flat plate-like bases 4 made of titanium by a hydrothermal method. Electrode films 6 having several thickness made of



aluminum are formed on the PZT thin films 5  $\mu$ m at both the surface and back sides of the bases. The thickness of the bases 4 is supposed to be 20  $\mu$ m.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# 四公公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-1387

(49)公開日 平成11年(1999)1月6日

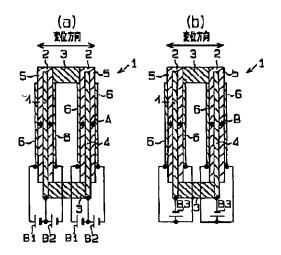
(51) Int.CL*		識別記号	۲ı		
CROR 7	7/10		C30B 7/10		
29	9/32		29/32		
G01L	1/16		G01L 1/16		
H01L 4	•		H01L 41/08	М	
	1/24		41/22 A		
				・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(21)出願番号		<b>特願平9</b> -155109	(71)出版人 50124015	出劃人 501240157	
			福田 敷	男	
(22)出頁日		平成9年(1997)6月12日	愛知県名古庭市東区矢田町2 」 目66番地		
			(71)出頭人 59511282	3	
			新井 史	人	
			委知県名	古屋市千種区育都町8~6~1	
		-	(71)出遊人 00000355	1	
			株式会社	<b>乳海理化電機</b> 製作所	
			<b>爱</b> 如果丹	羽都大口町豊田三丁日260番地	
			(72) 発明者 福口 敏	<b>男</b>	
			名古風市	京区矢田町2丁目68番地 名人矢	
			田町宿舎		
			(74)代理人 弁理士		
			21 of a division of the service	最終耳に続く	

(54) 【発明の名称】 PZT薄原パイモルフ構造体、PZT薄原パイモルフ形の平行平板構造体、及びその具直方法

# (57)【要約】

【課題】容易に多数のパイモルフ構造を得ることができ、小型化が可能なPZT薄膜パイモルソ構造体を提供する。

【解決予段】平行平板構造体1は、一対のパイモルフ構造体からなる圧電素子2を互いに相対させ、その上下両端に対して角柱状の絶縁スペーケ3をそれぞれ挟んで互いに固若した構成とされている。パイモルフ構造体からなる圧電素子2は、チタンからなる平板状の基材4の表裏両面に対して厚さ数十μmのPZT薄膜5が水熟法により形成され、その表裏両面のPZT薄膜5上にはアルミニウムからなる厚き数μmの電極膜6が形成されている。基材4の厚みは20μmとされている。



#### 【特許諸本の範囲】

【請求項1】 チタン基材の第1の側面と、第1の側面 とは180度反対側に位置する第2の側面とに、PZT 護膝が形成され、前記PZT薄膜 Fに皆極がそれぞれ殺 けられたP2T薄膜パイモルフ操造体。

【請求項2】 テタン基材の第1の側面と、回第1の側 面とは180度反対側に位置する第2の側面とにPZT 薄膜が形成され、前記ピと丁葉膜上に電極がそれぞれ設 けられた一対のPZT蒸膜パイモルフ模質体が互いにス るP7.T薄膜パイモルフ形の平行平板構造体。

【請求項3】 水熱法により、チタン基材の第1の側面 と、第1の側面とは180度反対側に位置する第2の側 面とにPVT海峡を形成する工程と、

前記PNT海原上に対して、それぞれ電極を形成する工 程とを含むPZT薄膜バイモルフ構造体の製造方法。

【請求項1】 水熱法により、チタン基材の第1の側面 と、第1の側面とは180度反対側に位置する第2の側 面とにPグチ環膜を形成する工程と、

的記PZT薄膜上に対して、それぞれ複数の電管を形成 20 する工程と、

可いた陰傍した電極間を切断して複数のピス丁雄脱パイ モルフ禄道体を得る工程とを含むことを特徴とするPZ T 再膜パイモルフ 特造体の製造方法。

【諸求項5】 前記水熱法は、

| 始酸鉛溶液、オキシ塩化シルコニウ人を鉱化剤とともに 操作し、加圧及び加熱して、チタン基材の第1及び第2 の側面上に種了結晶を得る工程と、

前記種子結晶を得た基材に対して、硝酸鉛溶液、オキシ 塩化シルコニウム、四塩化チタンの溶液を鉱化剤ととも 30 に攪拌し、加熱及び加圧して、チタン基材の第1の側面 と、第1の側面とは180度反対側に位置する第2の側 面のそれぞれに対してPZTの結晶成長を行い、チャン 基材の第1及び第2の側面上にPZT薄膜を形成する工 程とを含むととを特徴とする調本項3又は調本項4に記 載のPZT薄膜パイモルン機造体の製造方法。

#### 【発明の評細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はPZT薄膜バイモルフ操 造体、PZT薄膜バイモルノ形の平行平板構造体、及び 40 その製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来から圧電素子としてバルクのPZT (シルコン・チタン酸鉛:チタン酸鉛,シルコン酸鉛の 因落体からなるセラミックス) 素子を嵌伏の基材の表裏 両面にそれぞれ設け、可記P2T素子の表面に電極を設 けたバイモルフ(Bimoroh)環境体が知られてい る。とのバイモルフ橙造体は、両PZT素子に対して電 圧を印加すると、一方のPZT素子が引き伸ばされ、他 方のP2T聚了が圧縮されて、構造体の全体が変形した。50 【0010】請求項4の発明は、水熱法により、チタン

クチュエータとして利用される。又、逆に一方のPZT 業子を引き伸ばし、他方のPZT素子を圧縮した場合に は、1つのPZT案子(圧電素子)の場合よりも2倍の 電圧を発生するセンサとして利用される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のよう なパイモルフ構造体は、パルクのPST紫子を使用して いるため、パルクそのものの符形化が難しく、パイモル フ構造体全体の小型化が難しい問題があった。さらに、 ペーサを介して、平行に連結されていることを特徴とす 10 パルクのPZTを使用してバイモルフ構造を得ようとし た場合、バルクを基材の表真面にそれぞれ貼着する必要 があるため、貼着工程が多くなる問題があった。

> 【0004】又、バイモルフ構造体を構成する場合。1 枚のパイモルン模式体であると荷米のパイモルフ権各体 は板状に形成されているため、変位時に変位方向以外の 力が加わると捩じれた状態で変位しやすく、正確な変位 ができない問題もあった。さらに、従来のパイモルフ棋 造体は、バルクのP2丁索子を基材の表裏面面に貼着し て製造する必要があるため、1度に多くのパイモルフ櫓 造体を得るととができない問題もあった。

> 【0005】本発明は上記の課題を解消するためになる れたものであり、第1の目的は、容易に多数のパイモル フ構造を得ることができ、かつ小型のバイモルフ構造体 にすることができるPZT薄膜パイモルフ構造体を提供 するととにある.

> 【0006】第2の目的は、捩じれた強いPZT薄膜パ イモルフ形の平行平板構造体を提供するととにある。第 3の目的は、一度に多数のパイモルフ構造体を得ること ができる製造方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた めに、讃求項】に記載の発明は、チタン基材の第1の側 面と、第1の側面とは180度反対側に位置する第2の 側面とに、PZT轉膜が形成され、前記FZT薄膜上に 電極がそれぞれ設けられたPZT薄膜バイモルノ做造体 をその異旨としている。

【0008】網求項2の発明は、チタン基材の第1の側 面と、同第1の側面とは180度反対側に位置する第2 の側面とにPZT薄膜が形成され、前記PZT薄膜上に 宣極がそれぞれ設けられた一対のピスコ漁順パイチルブ 模造体が互いにスペーサを介して、平行に連結されてい るととを特徴とするF2T薄膜バイモルフ形の平行平板 **煙道体をその要旨としている。** 

【0009】請求項3の発明は、水熱法により、チタン 基材の第1の側面と、第1の側面とは180度反対側に 位置する第2の側面とにPZT薄膜を形成する工程と、 前記セス丁返順上に対して、それぞれ電極を形成する工 程とを含むPZT碡膜バイモルフ構造体の製造方法をそ の要旨としている。

10

芸材の第1の側面と、第1の側面とは180度反対側に 位置する第2の側面とにPZT薄膜を形成する工程と、 前記P2T薄膜上に対して、それぞれ複数の電極を形成 する工程と、互いに隣接した電極間を切断して複数のP 2.丁運順バイモルフ構造体を得る工程とを含むことを特 徴とするP2T薄膜パイモルフ操造体の製造方法をその 要旨としている。

【0011】請求項5の発明は、請求項3叉は請求項4 において、前記水熟法は、硝酸鉛溶液、オキシ塩化ジル コニウムを鉱化剤とともに攪拌し、加圧及び加熱して、 チタン基材の第1及び第2の側面上に種子結晶を得る工 程と、前記稗子結晶を得か基材に対して、硝酸鉛溶液、 オキシ塩化ジルコニウム、四塩化チタンの溶液を鉱化剤 とともに攪拌し、加熱及び加圧して、チタン基材の第1 の側面と、第1の側面とは180度反対側に位置する第 2の側面のそれぞれに対してP2Tの結晶成長を行い、 チタン基材の第1及び第2の側面上にPZT薄膜を形成 する工程とを含むことをその要旨としている。

(作用) 請求項 (に記載の発明によると、チタン基材の) 第1及び第2の側面に形成されたPZT簿膜は、薄いた(20)1の側面とは180度反対側に位置する第2の側面に相 め、PZT薄膜パイモルフ橡造体は、小型化がされる。 【00】2】請求項2に記載の発明は、平行平板構造と されて剛性が付与されるため、捩じれに対して強くな る。謂來項3の発明によると、水熱法により、チタン基 材の第1及び第2の側面にP2T漠膜が形成され、その 後、前記PZT薄膜に対して、それぞれ電極が形成され るととにより、P2T薄膜パイモルフ榴造体となる。と とで、水熱法とは、加熱・加圧下の水溶液から結晶を折 出、成長させる方法をいう。又、加圧とは、積極的に圧 刀を加える場合の他、圧力容器内において、加熱により 30 **蒸気圧の圧力上昇を含む起旨である。なお、水熱法は、** 一般的には水熱合成法ともいうが、この明細書では、水

【0013】諸求項4に記載の発明によると、水熱法に より、チタン基材の第1及び第2の側面にPZT薄膜が 形成され、その後、前記PZT苺膜に対して、それぞれ 複数の電極が形成される。そして、互いに隣接した電極 間が切断されると、複数のP2T港膜バイモルフ構造体

【0014】 請求項5 に記載の発明によると、硝酸鉛格 40 薇、オキシ塩化ジルコニウムを鉱化剤とともに資拌し、 加圧及び加熱して、チタン基材の第1及び第2の側面上 に程子結晶を得る。その後、前記程了結晶を得た基材に 対して、硝酸鉛溶液、オキン塩化ジルコニウム、四塩化 テタンの辞液を拡化剤とともに登拌し、加熱皮び加圧し て、チタン基材の第1及び第2の側面のそれぞれに対し てP2Tの結晶成長を行うと、チクン基材の第1及び第 2の側面にPZT薄膜を得る。

[0015]

【実施の形態】以下、本発明の実施形態を図】乃至図1 50 むいては、右方へ変位する)。

Lを参照して説明する。図l(a),(b)はP.7.T蓮 膜バイモルフ形の平行平板構造体の断面図を示してい る。又、図りはPZT薩胶パイモルフ形の平行平板構造 体の斜視図を示している。なお、上記図面を含む各図面 **区図示されている各部材の度みは、説明の使宜上、実際** のものより適宜拡大して図示されている。

【0010】図1(u), (b) に示すように平行平板 **福治体上は、一対のバイモルフ福治体からなる平板状の** 圧電素子2を互いに相対させ、その上下両端に対して角 住状の絶縁スペーサコをそれぞれ挟んで互いに固着した 構成とされている。なお、絶縁スペーサ3としたのは、 注意素チン間の短路防止のためである。

【0017】バイモルフ保造体からなる圧電表子2は、 厚みが均等に形成された平板状をなすチタンからなる基 **材(チタン基材)4の両側面に対して厚き数十μmのP** ZT海原5が形成され、その表裏両面のPZT薄膜5上 にはアルミニウムからなる厚さ数μmの電極膜6が形成 されている。基材4の厚みは20μmとされている。前 記巻材4の両側面は本発明における第1の側面。及び第 当する。又、電極膜のは本発明の電極に相当する。

【0018】図】(a). (b) には、上記のように悌 成されたドム丁醇腔パイモルフ形の平行半板構造体1を アクチュエータとして使用する場合の電気回路を示して いる。図1(a)は、PZT薄膜5の分極が方向Aの場 合であり、直流低波B1、B2をそれぞれ直列に接続し て、道流電源B1のブラス端子を、図1において各圧電 索子2の左側の側面の電極膜6に接続し、道流電源B2 のマイナス端子を右側の側面の篦椅膜6 に接続し、直流 電源B1. B2の中間接続点を基材4に接続している。 これは、チタン基村4の両面側に形成されるPZT薄膜 5のそれぞれに、均一に電界を印加するためであり、P 乙丁運験5の膜壁が均一であれば、南流電源B1.B2 の中間接続点を基材4に接続する必要はない。なお、直 流電源B1, B2は同電圧を各電極度6を介してP2T 薄膜5に印加するようになっている。

【0018】そして、上記の平行平板構造体1の下端を 図示しない台等に固定した状態で、図1(g)に示すよ うに一対の圧電素子2の同一方向側に位置する側面に対 し電極膜6を介して回極性の電圧を印加すると、プラス 電位側UFF加された方のPZT薄膜5は圧縮され、マイ ナス電位に印加された側のPZT薄膜5は引き仲ぱされ る(図I(a)においては、左方へ変位する)。又、図 1(8)とは逆極性の電圧を各側面の電極限のを介して 印加した場合には、前紀とは反対側に位置するブラス電 位側に印加された側面(図1(a)において、各圧電素 子2の右側面)のPZT蹲瞭5は圧縮され、マイナス電 位に印加された側面(図)において、各用電素子2の左 側面)のPZT薄膜5は引き伸ばされる(図1(a)に 5

[0020] 図1(b)は、PZT核既5の分極が方向 Bの場合であり、直流電源B3のマイナス端子を基材4に接続し、ブラス端子を各圧電素子2の左右の側面の電極度6に接続している。図1(h)に示すように一対の圧電素子2の所側面に位置する電極度8を介してブラス電位を印加すると右側のPZT模膜5は引き伸ばされ、左側のPZT模膜5は圧縮される(図1(b)においては、左側へ変形する)、X 図1(h)とは、短極性の電圧を印加した場合には、前記と反対方向の右側に変形する。との場合は、図1(a)の1/2の電圧で、同じ量の変位が得られる。

100211又、上記の説明ではアクチュエータとして 説明したが、変位センサとして使用することも可能である。この場合は、上記の平行平板構造体1の下端を図示 いない台等に固定した状態で、図1において、上端を左 方又は右方へ変位すると、圧電素子2の圧縮された側面 のP2下蹲膜5と、引き伸ばされた側面のP2下薄膜5 とは、それぞれ逆電位の電圧が生ずる。この電圧の変化 を検出すると、変位センサとして使用することができる。なお、この変位センサは、この実施形態では単一の 足世業子2から生ずる電圧と比較して、一対の圧電素子 2から電圧が生ずるため、2倍の電圧を得ることができる。

【0022】次に、上記平行平板梯造体1の製造方法を図2乃至図9を参照して説明する。図2は、基材4Aをポレている。チダンからなる番材4Aは、厚みが均等に形成された平板伏をなしており、前記基材4の複数個分の面積を有している。まず、この基材4Aを破等で、ケリーニングし、テめ、一端側(図1において、基礎となる側)を合成樹脂、又は、スパッタリングや真空蒸着等30の物理的成膜法にてチタン以外の金属等にて、被覆してマスクMを形成し、次に水熱法で、PZT薄膜5を両面に形成する。

【0023】との水無法は2つの段階からなっている。 (第1段階)基材4A、原材料としてのオキシ塩化シルコニウム(ZrOC、・8H,0)と硝酸塩(Pb(NO,)。)の水溶液、及びKOH(8N)溶液をテフロン紙(図示しない)に投入し、提押する。なお、PZT薄膜5の圧電性は、PZT薄膜5におけるチタン酸鉛。ジルコン酸鉛の構成組成比によって決まるため、後にで40きあがるPZT薄膜5の圧電性と応じてオキシ塩化ジルコニウムと硝酸塩とのモル比を決めればよい。

【0024】次に、図示しない圧力容器内において、基材4Aを上方に配置し、オキシ塩化ジルコニウム(2r OC: ・8H, O)、研酸塩(Pb(NO:)。)の水溶液、及びKOH(8N)溶液を撹拌しながら、加熱・加圧する。なも、ここでいう加圧とは、加熱された溶液の蒸気圧よる加圧のととである。温度条件は150℃で、48時間との伏鏡を維続する。なお、攪拌は、300гッカで行う。

【0025】との結果、過飽和状態で、玉材4Aの平板 状の両側面にPZTの種子結晶(核)が形成される。上 紀時間の経過後、基材4Aを圧力容器から取り出し、水 洗、乾燥する。

【0026】 (第2段階) 次に、種子結晶が核付けされた基材4A、原材料としてのオキシ塩化ジルコニウム (ZrOC,・8H,O)と硝酸塩(Pb(NO,),)の水溶液、四塩化チタン(TiCl,)及びKOH(4N)溶液をテフロン瓶(図示しない)に投入し、超れた4、R2、TRMで10円で出せ、R2、TRMで10円で出ている。

する。との場合は、図1 (a)の1/2の電圧で、同じ 10 し、撹拌する。なお、PスT薄膜5の圧電性は、PZT量の変位が得られる。 におけるチタン酸鉛、ジルコン酸鉛の橙成組成比化よって決まるため、後にできあがるPZTの圧電性に応じて説明したが、変位センサとして使用するととも可能である。との場合は、上記の平行平板構造体1の下端を図示 よい。

【0027】次に、図示しない圧力容恐内において、基材4Aを上方に配置し、オキシ塩化ジルコニウム(ZrOCz・8H、O)、硝酸塩(Pb(NO、)。)の水溶液、四塩化チタン(TiCl。)及びKOH(4N)熔液を攪搾しながら、加熱・加圧する。なお、ことでいう加圧とは、加熱された溶液の蒸気圧よる加圧のととである。温度条件は120°Cで、48時間との状態を継続する。なお、攪拌は、300rpmで行う。

【0028】との結果、過飽和状態で、基材4Aの平板状の両側面にPZT薄膜5が所定厚み(この実施形態では数十μm)で形成される(図3参照)。上記時間の経過後、基材4Aを圧力容器から取り出し、水洗・乾燥する。この後、マスクMを除去する。

【0028】次に、図4に示すように、P2T薄膜5を含む、基材4Aの両側面に電極限6をスパッタリングや真空蒸荷等の物理的成膜法により形成する。そして、基材4Aに対して複数個分(との実施形態では3個分)の圧電素子2が取れるようにその表裏両面をパターニングし、小必要な電極膜6の部分を除去する(図5及び図6参照)。

【0030】続いて、図7に示すようにP2T薄膜5、 電板膜6を備えた一対の基材4Aを且いに相対させ、そ の両端間において、合成樹脂からなる角柱状の絶縁スペーサ3を介して互いに固著し、平行平板構造体1Aとす る。との平行平板構造体1Aは、単一の平行平板構造体が互いに通結された構成となっている。なお、絶縁スペーサ3は、硬化時に剛性の高い接着剤にて基材4Aを固着する(図8参照)。

【0031】次に、図8の平行平板保資体1Aを点線物 所にて切断し、単一の平行平板保資体1に分離する。な お、この切断は、放電加工、或いはレーザカットにで行 う。さて、本実施形態によると、次のような作用効果を 参する。

【0032】(1) 本実施形態では、基材4の両側面 に形成されたPZT薄膜5は、数十μmとして薄く形成 50 しているため、PZT薄膜パイモルフ構造体としての圧 電索子2を、小型化することができる。

【0033】(2) 本実施形態では、一対のバイモル フ格造体からなる圧電素了2を互いに相対させ、平行平 板構造としているため、捩じれに対して強くすることが できる。

【0031】図10(a)は、単一のバイモルフ構造体 10が振動する場合を示し、図10(1)は、同じく単 一のパイモルフ部省体10が振動しているときであっ て、上方から見た場合における、パイモルフ樽造体10 置P1は変位前の位置、P2は、中央位置P1から一方 に変位した場合の位置、ド3は中央位置と1から、ド2 とは反対側の他方の位置に変位した場合の位置を示して いる。この場合、単 のパイモルフ構造体10は平板状 に形成されているため、振動方向以外の力が加わると、 図10(b)のP2、P3に示すように捩じられてしま う問題がある。なお、図10(b)において、二点鎖線 は、捩じれが加わらなかった場合のバイモルフ様造体1 0の変位位置である。

【0035】図11(g)は、木実施形態の平行平板構 20 造体1が振動する場合を示し、図11(b)は、同じく 平行平板構造体1が振動しているときであって、上方か 6見た場合における平行平板構造体1の上端の変位位置 を示している。

【0036】図11(b)の中央位置P1は変位前の位 置、P2は、中央位置P1から一方に変位した場合の位 置、P3は中央位置P1から、P2とは反対側の他方の 位置に変位した場合の位置を示している。との場合、平 行平板構造体1は、振動力向以外の力が加わっても、阿 性があるため、涙じれに強く、凶 1 1 (b) の P2, P 30 体にすることができる。 3に示すように戻じられてしまうことはない。

【0037】、なお、図10及び図11はともに、説明 の便宜上、電極膜、PZ丁薄膜は省略して図示してい

(3) 本実施形態では、水熱法により、複数個分の基 材4の面積を有する基材4Aの両側面にF2T溝膜5を 形成し、その後、基材4Aの両側面に対して、電優膜 5 を形成した。との結果、一度に複数側の基材なに対して P2T薄膜5及び電極膜6を形成できるため、従来と思 なり、一度に多くのバイモルフ構造体を形成することが 40 できる。

[0038](4) 本実施形態では、水熱法により、 基材4Aの両側面にPZT薄膜5を形成し、その後、前 記PZT薄膜5を形成した基材4Aの両側面に対して、 それぞれ複数の苦極燥者を形成し、互いに隣接した電極 8間を切断すると、複数のPZT薄膜パイモルフ標準体 を得るととができる。

【0039】本発明の実施形態は、上記実施形態以外に 次のように変更することも可能である。

(1) 前記実施形態では、絶縁スペーサるとしたが、

肝雷素子2間において、餌絡の値がないように形成した 場合には、金属製スペーサのように非絶縁性のスペーサ にて梯成してもよい。との場合、圧電素了2に対する関 者は浴接等により行う。

【0040】(2) 前記実施形態では、宣権収6をア ルミニウムで形成したが、 Au (金) にて形成してもよ く、又、他の金属にて形成してもよい。

(3) 前記主施形形では、電極風8、P2T液膜5、 基材1の厚みをそれぞれ所定数値としたが、上記数値に の上端の変位位置を示している。図10(b)の中央位 10 限定されるものではなく、必要に応じて、上記以外の数 値としてもよい。

> (0041)(4) 前記実施形態では、3個のバイモ ルフ掃控体の製造について説明したが、との個数には限 定されるものではなく、2個、或いは4個以上のものを 一度に形成するようにしてもよい。なお、勿論1個のバ イモルフ禰遊体を製造することも可能である。

> 【0042】ととで、特許請求の範囲に記載された技術 的思想のほかに、前述した実施形態によって把握される 技術的思想をその効果とともに以下に挙げる。

(1) 請求項3乃至請求項6のいずれかにおいて、P 2 T 薄膜を形成する工程の前に、下めチャン基材の所定 部分には、マスクを励したPZT薄度ハイモルン構造体 の製造方法。とうすることにより、マスクされた部分に は、PZT薄膜を形成できないようにするととができ る.

[0043]

【発明の効果】以上評述したように、諸求項1の発明に よれば、容易に多数のバイモルフ構造を得るととがで き、又、P Z T 薄膜となるため、小型のバイモルン構造

【0044】請求項2の発明によれば、捩じれに強い口 ZT薄膜パイモルフ形の平行平板構造体とすることがで きる。韓東県3万年韓東県5の発明によれば、一度に参 数のパイモルコ構造体を得るととができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】(a),(b)はP2T体膜パイモルフ形の平 行平板構造体の影面図。

【図2】基材の断面図。

【図3】PZT薄膜にて被覆した状態の基材の断面図。

【図4】電極膜を形成した基材の断面図。

【図5】電極原をバターンニングして形成された圧電素 子の断面図。

【図8】同じく圧電素子の斜根図。

【図7】平行平板梯造体の組付け万法を示す分解料視

【図8】平行平板構造体を組付けた状態の斜視図。

【図9】P2T薄膜バイモルフ形の平行平板構造体の斜

【図10】(a)は単一のPZT薄膜バイモルフ構造体 50 の作用を示す斜視図、(b)は同じく説明図。

【図11】(a) は平行平板操作体の作用を示す斜視図、(b) は同じく説明図。 【初号の説明】 \* !…平行平板機造体、2…圧電条子、3…絶縁スペーサ、4,4A…基材、5…PZT薄膜、8…電極膜。

[図3] [図1] [四2] [図6] [図9] [図7] [24] [閏5] [8图] [図10] [図11] (a) (a) (b) (b)

(手統補正答)

【提出日】平成9年7月17日

【手統補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0024

【補正方法】変更

【補正内容】

【0024】次に、図示したい圧力容器内において、基材4Aを上方に配置し、オキシ塩化ジルコニウム(ZrOCl2・8H、O)、硝酸塩(Pb(NO。)。)の水溶液、及びKOH(8N)溶液を攪拌しながら、加熱・加圧する。なお、ここでいう加圧とは、加熱された溶液の蒸気圧による加圧のととである。温度条件は130℃で、48時間この状態を継続する。なむ、攪拌は、300rpmで行う。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0026

【補正内容】

【0026】(第2段階)次に、種子結晶が核付けされた基材4A、原材料としてのオキン塩化ジルコニウム ホ

\* (ZrOC1: ・8H, O)と硝酸塩(Pb(NU,);)。)の水溶液、四塩化チタン(TiC1,)及びKOH(4N)溶液をテフロン瓶(図示しない)に投入し、提件する。なお、PZT溶膜5の圧電性は、PZTにおけるチタン酸鉛,ジルコン酸鉛の構成組成比によって決まるため、後にできあがるPZTの圧電性に応じてオキシ塩化ジルコニウムと硝酸塩とのモルルを決めればよい。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明知書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】 突用

【補正内容】

#### フロントページの続き

(72) 発明者 新井 史人

名古屋市干種区青柳町8丁日5番地の1 メイツ千種青柳501 (72)発明者 糸魚川 貸一

愛知県丹羽郡大口町大字豊田字野田1番地 株式会社束海理化電機製作所內

(72)発明者 岩田 仁

愛知原丹羽郡大口町大字豊田字野田 1 番地 株式会社東海理化電機製作所内

## Confirmation Report - Memory Send

Date & Time: Sep-15-2004 08:10am

Tel line : 315 233 8320 Machine ID: BURR AND BROWN

Job number

: 775

Date & Time

: Sep-15 08:07am

To

: 901181333201393

Number of pages

: 001

Start time

: Sep-15 08:08am

End time

: Sep-15 08:09am

Pages sent

Job number

: 001

Status

: OK

: 775

\*\*\* SEND SUCCESSFUL \*\*\*

2004年 9月15日 15時46分 TOHO INT'L PATENT & LAW OFFICE

NO. 1310 P. 1

# FACSIMILE TRANSMISSION

DATE: September 15, 2004

PAGE(S): 25

To:

Stephen F. Burr, Esq. DURR & BROWN 101 South Salina Street 7th Floor Syracuse, New York 13202 U. S. A.

Yoshihiro CHIBA
TOHO INTERNATIONAL PATENT & LAW OFFICE
TOKYO 151-0053, JAPAN
Pacsimile Number: 81-3-3320-1393 (GIII, GIV)
Telephone Number: 81-3-3320-1393
Telephone Number: 81-3-3320-1393
E-mail: Tohofohibapat.co.ip

YOUN TOF : 789 064 OUR ESE, 1 00P356CA-US00/SD/II

Please acknowledge receipt of this message.

Special message:

Re: Information Disclosure Statement



ORTANT/CURFIDENTIAL: This communication is intended only for the use of the individual intity to whom it is addressed and may continue into individual intity to whom it is addressed and may continue in the reader of this message is not extend from the individual in the reader of this message is not like in the individual in the reader of this message is not the reader of this desired in the individual individ

JAPANESE [JP,11-001387,A]
CLAIMS <u>DETAILED DESCRIPTION TECHNICAL FIELD PRIOR ART EFFECT OF</u> <u>THE INVENTION TECHNICAL PROBLEM MEANS OPERATION DESCRIPTION OF</u> <u>DRAWINGS DRAWINGS</u>
[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### **CLAIMS**

# [Claim(s)]

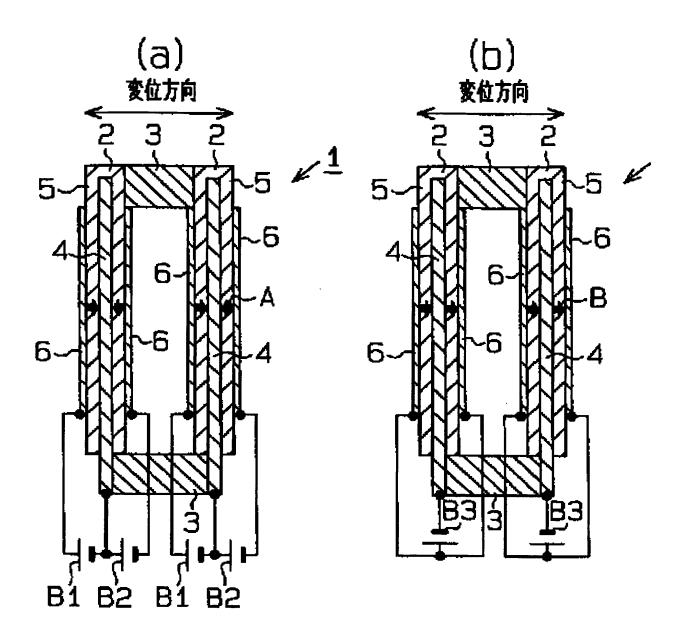
[Claim 1] The 1st side face of a titanium base material and the 1st side face are the PZT thin film bimorph structure by which the PZT thin film was formed in the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees, and the electrode was prepared on said PZT thin film, respectively.

[Claim 2] The 1st side face and this 1st side face of a titanium base material are the parallel flat sheet structure object of the PZT thin film bimorph form characterized by connecting mutually in parallel the PZT thin film bimorph structure of the pair by which the PZT thin film was formed in the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees, and the electrode was prepared on said PZT thin film, respectively through a spacer. [Claim 3] It is the manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure including the process which forms a PZT thin film in the 2nd side face in which the 1st side face of a titanium base material and the 1st side face are located in the opposite side 180 degrees by the hydrothermal method, and the process which forms an electrode to said PZT thin film top, respectively.

[Claim 4] It is the manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure characterized by to include the process at which the 1st side face of a titanium base material and the 1st side face form a PZT thin film in the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees, by the hydrothermal method, the process which forms two or more electrodes to said PZT thin film top, respectively, and the process which disconnects inter-electrode [ which adjoined mutually ] and obtains two or more PZT thin film bimorph structures.

[Claim 5] Said hydrothermal method stirs a lead nitrate solution and zirconium oxychloride with a mineralizer, and pressurizes and heats them. As opposed to the process which obtains a seed crystal on the 1st of a titanium base material, and the 2nd side face, and the base material which obtained said seed crystal Stir the solution of a lead nitrate solution, zirconium oxychloride, and a titanium tetrachloride with a mineralizer, and it is heated and pressurized. The 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees boils the 1st side face of a titanium base material, and the 1st side face, respectively, receive, and crystal growth of PZT is performed. The manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure according to claim 3 or 4 characterized by including the process which forms a PZT thin film on the 1st of a titanium base material, and the 2nd side face.

[Translation done.]



#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

#### DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] This invention relates to the PZT thin film bimorph structure, the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form, and its manufacture approach.

[0002]

[Description of the Prior Art] The bimorph (Bimorph) structure which prepared from the former the PZT (zircon lead titanate: ceramics which consists of the solid solution of lead titanate and lead zirconate) component of bulk in front flesh-side both sides of a tabular base material as a piezoelectric device, respectively, and prepared the electrode in the front face of said PZT component is known. If an electrical potential difference is impressed to both the PZT(s) component, one PZT component will be extended, the PZT component of another side will be compressed, and the whole structure will deform this bimorph structure, and it will be used as an actuator. Moreover, when a PZT component is extended conversely [while] and the PZT component of another side is compressed, it is used as a sensor which generates a twice as many electrical potential difference as this rather than the case of one PZT component (piezoelectric device).

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, since the above bimorph structures were using the PZT component of bulk, the formation of a thin form of the bulk itself was difficult for them, and they had the problem that the miniaturization of the whole bimorph structure was difficult. Furthermore, since it was necessary to stick bulk on the front rear face of a base material, respectively when it is going to acquire bimorph structure using PZT of

bulk, there was a problem more than which an attachment process increases.

[0004] Moreover, when the bimorph structure was constituted, since the conventional bimorph structure was formed in tabular with it being the bimorph structure of one sheet, it was easy to displace in the condition of having been twisted when force other than the displacement direction was added at the time of displacement, and there was also a problem which cannot do an exact variation rate. Furthermore, since the conventional bimorph structure needed to stick the PZT component of bulk on front flesh-side both sides of a base material and needed to manufacture it, there was also a problem which cannot obtain many bimorph structures at a time.

[0005] This invention is made in order to cancel the above-mentioned technical problem, and the 1st purpose is to offer the PZT thin film bimorph structure which can acquire much bimorph structures easily and can be made into the small bimorph structure.

[0006] The 2nd purpose is to offer the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form strong against a twist. The 3rd purpose is to offer the manufacture approach that much bimorph structures can be obtained at once.

# [0007]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, a PZT thin film is formed in the 2nd side face in which the 1st side face of a titanium base material and the 1st side face are located in the opposite side 180 degrees, and, as for invention according to claim 1, the electrode makes the summary the PZT thin film bimorph structure prepared, respectively on said PZT thin film.

[0008] A PZT thin film is formed in the 2nd side face in which the 1st side face and this 1st side face of a titanium base material are located in the opposite side 180 degrees, and invention of claim 2 makes the summary the parallel flat sheet structure object of the PZT thin film bimorph form characterized by connecting mutually in parallel the PZT thin film bimorph structure of the pair by which the electrode was prepared on said PZT thin film, respectively through a spacer.

[0009] Invention of claim 3 makes the summary the manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure that the 1st side face of a titanium base material and the 1st side face include the process which forms a PZT thin film in the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees, and the process which forms an electrode to said PZT thin film top, respectively, by the hydrothermal method.

[0010] The process at which invention of claim 4 forms a PZT thin film in the 2nd side face in which the 1st side face of a titanium base material and the 1st side face are located in the opposite side 180 degrees, by the hydrothermal method, The manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure characterized by including the process which forms two or more electrodes, respectively, and the process which disconnects inter-electrode [ which adjoined mutually ] and obtains two or more PZT thin film bimorph structures to said PZT thin film top is made into the summary.

[0011] Invention of claim 5 is set to claim 3 or claim 4. Said hydrothermal method Stir a lead nitrate solution and zirconium oxychloride with a mineralizer, and they are pressurized and heated. As opposed to the process which obtains a seed crystal on the 1st of a titanium base material, and the 2nd side face, and the base material which obtained said seed crystal Stir the solution of a lead nitrate solution, zirconium oxychloride, and a titanium tetrachloride with a mineralizer, and it is heated and pressurized. the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees boils the 1st side face of a titanium base material, and the 1st side face, respectively, they receive, perform crystal growth of PZT, and make it the summary to include the process which forms a PZT thin film on the 1st of a titanium base material, and the 2nd side face.

(Operation) Since the PZT thin film formed in the 1st and 2nd side faces of a titanium base material is thin according to invention according to claim 1, as for the PZT thin film bimorph structure, a miniaturization is carried out.

[0012] Since it considers as parallel flat sheet structure and rigidity is given, invention according to claim 2 becomes strong to a twist. According to invention of claim 3, it becomes the PZT thin film bimorph structure by forming a PZT thin film in the 1st and 2nd side faces of a titanium base material, and forming an electrode to said PZT thin film after that by the hydrothermal method, respectively. Here, a hydrothermal method means the approach of depositing and growing up a crystal from the water solution under heating / pressurization. Moreover, pressurization is the meaning which contains the pressure buildup of vapor pressure with heating in a pressurized container besides in the case of applying a pressure positively. In addition, although a hydrothermal method is generally also called hydrothermal crystallization method, it is called hydrothermal method on these specifications.

[0013] According to invention according to claim 4, by the hydrothermal method, a PZT thin film is formed in the 1st and 2nd side faces of a titanium base material, and two or more electrodes are formed to said PZT thin film after that, respectively. And cutting of inter-

electrode [ which adjoined mutually ] obtains two or more PZT thin film bimorph structures. [0014] According to invention according to claim 5, a lead nitrate solution and zirconium oxychloride are stirred with a mineralizer, are pressurized and heated, and a seed crystal is obtained on the 1st of a titanium base material, and the 2nd side face. then, if stir the solution of a lead nitrate solution, zirconium oxychloride, and a titanium tetrachloride with a mineralizer, and it is heated and pressurized, and the 1st and 2nd side faces of a titanium base material are alike, respectively, it receives to the base material which obtained said seed crystal and crystal growth of PZT is performed, a PZT thin film will be obtained on the 1st and 2nd side faces of a titanium base material. [0015]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the operation gestalt of this invention is explained with reference to <u>drawing 1</u> thru/or <u>drawing 11</u>. <u>Drawing 1</u> (a) and (b) show the sectional view of the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form. Moreover, <u>drawing 9</u> shows the perspective view of the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form. In addition, for convenience, from the actual thing of explanation, the thickness of each part material currently illustrated by each drawing containing the abovementioned drawing is expanded suitably, and is illustrated.

[0016] As shown in <u>drawing 1</u> (a) and (b), the parallel flat sheet structure object 1 makes the plate-like piezoelectric device 2 which consists of the bimorph structure of a pair face mutually, and is considered as the configuration which fixed mutually respectively on both sides of the prismatic form insulating spacer 3 to the vertical both ends. In addition, it considered as the insulating spacer 3 because [ of the short circuit prevention between piezoelectric devices 2].

[0017] The electrode layer 6 with a thickness of several micrometers to which the PZT thin film 5 of 10 micrometers of thickness numbers is formed, and consists of aluminum on the PZT thin film 5 of the front flesh-side both sides is formed to the both-sides side of the base material (titanium base material) 4 which consists of titanium with which the piezoelectric device 2 which consists of the bimorph structure makes plate-like [ in which thickness was formed equally ]. Thickness of a base material 4 is set to 20 micrometers. The both-sides side of said base material 4 is equivalent to the 1st side face in this invention, and the 2nd side face in which it is located in the opposite side 180 degrees with the 1st side face. Moreover, an electrode layer 6 is equivalent to the electrode of this invention.

[0018] The electrical circuit in the case of using as an actuator the parallel flat sheet structure object 1 of the PZT thin film bimorph form constituted as mentioned above for drawing 1 (a) and (b) is shown. Drawing 1 (a) is the case where polarization of the PZT thin film 5 is Direction A, it connected DC power supply B1 and B-2 to the serial, respectively, connected the plus terminal of DC power supply B1 to the electrode layer 6 of the side face on the left-hand side of each piezoelectric device 2 in drawing 1, connected the minus terminal of DC-power-supply B-2 to the electrode layer 6 of a right-hand side side face, and has connected DC power supply B1 and the middle node of B-2 to a base material 4. This is for impressing electric field to homogeneity at each of the PZT thin film 5 formed in both-sides side of the titanium base material 4, and if the thickness of the PZT thin film 5 is uniform, it does not need to connect DC power supply B1 and the middle node of B-2 to a base material 4. In addition, DC power supply B1 and B-2 impress this electrical potential difference to the PZT thin film 5 through each electrode layer 6.

[0019] In and the condition of having fixed to the base which does not illustrate the lower limit of the above-mentioned parallel flat sheet structure object 1 If the electrical potential difference of like-pole nature is impressed through an electrode layer 6 to the side face in which it is located in the same direction side of the piezoelectric device 2 of a pair as shown in <u>drawing 1</u> (a) The PZT thin film 5 of the direction impressed to the plus potential side is compressed, and the near PZT thin film 5 impressed to minus potential is extended (in

drawing 1 (a), it displaces to a left). moreover, when the electrical potential difference of reversed polarity is impressed through the electrode layer 6 of each side face with drawing 1 (a) The side face impressed to the plus potential side located in the opposite side with the above (in drawing 1 (a)) The PZT thin film 5 of the right lateral of each piezoelectric device 2 is compressed, and the PZT thin film 5 of a side face (it sets to drawing 1 and is the left lateral of each piezoelectric device 2) impressed to minus potential is extended (in drawing 1 (a), it displaces to the method of the right).

[0020] <u>Drawing 1</u> (b) is the case where polarization of the PZT thin film 5 is Direction B, connected the minus terminal of DC power supply B3 to the base material 4, and has connected it to the electrode layer 6 of the side face of right and left of a plus terminal of each piezoelectric device 2. If plus potential is impressed through the electrode layer 6 located in the both-sides side of the piezoelectric device 2 of a pair as shown in <u>drawing 1</u> (b), it is extended, and the left-hand side PZT thin film 5 is compressed (it deforms into left-hand side in <u>drawing 1</u> (b)), and the right-hand side PZT thin film 5 will deform it into the right-hand side of the above and an opposite direction with <u>drawing 1</u> (b), when the electrical potential difference of reversed polarity is impressed. In this case, it is one half of the electrical potential differences of <u>drawing 1</u> (a), and the same quantity of a variation rate is obtained.

[0021] Moreover, although the above-mentioned explanation explained as an actuator, it is also possible to use it as a displacement sensor. In this case, it is in the condition fixed to the base which does not illustrate the lower limit of the above-mentioned parallel flat sheet structure object 1, and in drawing 1, if upper limit is displaced to a left or the method of the right, the electrical potential difference of reverse potential will produce the PZT thin film 5 of the side face in which the piezoelectric device 2 was compressed, and the PZT thin film 5 of the extended side face, respectively. If change of this electrical potential difference is detected, it can be used as a displacement sensor. In addition, with this operation gestalt, since an electrical potential difference arises from the piezoelectric device 2 of a pair as compared with the electrical potential difference produced from the single piezoelectric device 2, this displacement sensor can obtain the electrical potential difference which it is. [0022] Next, the manufacture approach of the above-mentioned parallel flat sheet structure object 1 is explained with reference to drawing 2 thru/or drawing 9. Drawing 2 shows base material 4A. Base material 4A which consists of titanium is making plate-like [ in which thickness was formed equally 1, and has the area for plurality of said base material 4. First, this base material 4A is cleaned from an acid etc., beforehand, an end side (side which serves as a end face in drawing 1) is covered with metals other than titanium etc. by the physical forming-membranes methods, such as synthetic resin or sputtering, and vacuum deposition, Mask M is formed, and then the PZT thin film 5 is formed in both sides by the hydrothermal

[0023] This hydrothermal method consists of two phases.

(The 1st step) Base material 4A, the zirconium oxychloride (ZrOC2 and 8H2 O) as a raw material and the water solution of a nitrate (Pb2 (NO3)), and a KOH (8Ns) solution are fed into a Teflon bottle (not shown), and are stirred. In addition, since piezoelectric [ of the PZT thin film 5 ] is decided by the configuration presentation ratio of the lead titanate in the PZT thin film 5, and lead zirconate, it should just determine the mole ratio of zirconium oxychloride and a nitrate according to piezoelectric [ of the PZT thin film 5 done behind ]. [0024] Next, heating and pressurization of are done, arranging base material 4A up in the pressurized container which is not illustrated, and stirring zirconium oxychloride (ZrOC2 and 8H2 O), the water solution of a nitrate (Pb2 (NO3)), and a KOH (8Ns) solution. In addition, pressurization here is the vapor pressure \*\*\*\* pressurization of the heated solution. Temperature conditions are 150 degrees C and continue this condition for 48 hours. In addition, stirring is performed by 300rpm.

[0025] Consequently, the seed crystal (nucleus) of PZT is formed in the plate-like both-sides side of base material 4A in the state of supersaturation. Base material 4A is taken out from a pressurized container after the above-mentioned passage of time, and it rinses and dries. [0026] (The 2nd step) Next, a seed crystal feeds into a Teflon bottle (not shown) base material 4A by which nucleus attachment was carried out, the zirconium oxychloride (ZrOC2 and 8H2 O) as a raw material and the water solution of a nitrate (Pb2 (NO3)), a titanium tetrachloride (TiCl4), and a KOH (4Ns) solution, and stirs them. In addition, since piezoelectric of the PZT thin film 5 is decided by the configuration presentation ratio of the lead titanate in PZT, and lead zirconate, it should just determine the mole ratio of zirconium oxychloride and a nitrate according to piezoelectric [ of PZT done behind ]. [0027] Next, heating and pressurization of are done, arranging base material 4A up in the pressurized container which is not illustrated, and stirring zirconium oxychloride (ZrOC2 and 8H2 O), the water solution of a nitrate (Pb2 (NO3)), a titanium tetrachloride (TiCl4), and a KOH (4Ns) solution. In addition, pressurization here is the vapor pressure \*\*\*\* pressurization of the heated solution. Temperature conditions are 120 degrees C and continue this condition for 48 hours. In addition, stirring is performed by 300rpm. [0028] Consequently, the PZT thin film 5 is formed in the plate-like both-sides side of base material 4A by predetermined thickness (this operation gestalt dozens of micrometers) in the state of supersaturation (refer to drawing 3). Base material 4A is taken out from a pressurized container after the above-mentioned passage of time, and it rinses and dries.

Then, Mask M is removed.

[0029] Next, as shown in drawing 4, an electrode layer 6 is formed in the both-sides side of base material 4A containing the PZT thin film 5 by the physical forming-membranes methods, such as sputtering and vacuum deposition. And patterning of those front flesh-side both sides is carried out so that two or more piezoelectric devices 2 of a part (this operation gestalt three pieces) can be taken to base material 4A, and the part of the unnecessary electrode layer 6 is removed (refer to drawing 5 and drawing 6).

[0030] Then, base material 4A of the pair equipped with the PZT thin film 5 and the electrode layer 6 is made to face mutually, as shown in drawing 7, and it fixes mutually through the prismatic form insulating spacer 3 which consists of synthetic resin among the both ends, and is referred to as parallel flat sheet structure object 1A. This parallel flat sheet structure object 1A has the composition that the single parallel flat sheet structure object of each other was connected. In addition, the insulating spacer 3 fixes base material 4A with rigid high adhesives at the time of hardening (refer to drawing 8).

[0031] Next, parallel flat sheet structure object 1A of drawing 8 is cut in a dotted-line part, and it separates into the single parallel flat sheet structure object 1. In addition, this cutting is performed by the electron discharge method or laser cut. Now, according to this operation gestalt, the following operation effectiveness is done so.

[0032] (1) With this operation gestalt, since the PZT thin film 5 formed in the both-sides side of a base material 4 is thinly formed as dozens of micrometers, it can miniaturize the piezoelectric device 2 as the PZT thin film bimorph structure.

[0033] (2) With this operation gestalt, since the piezoelectric device 2 which consists of the bimorph structure of a pair is made to face mutually and is made into parallel flat sheet structure, it can strengthen to a twist.

[0034] Drawing 10 (a) shows the case where the single bimorph structure 10 vibrates, and drawing 10 (b) is a time of the same single bimorph structure 10 vibrating, and it shows the displacement location of the upper limit of the bimorph structure 10 at the time of seeing from the upper part. The location when the location at the time of displacing the mid gear P1 of drawing 10 (b) in the location before displacement, and displacing P2 from a mid gear P1 to one side and P3 displace P2 in the location of another side of the opposite side from a mid gear P1 is shown. In this case, the single bimorph structure 10 has the problem twisted as

shown in P2 and P3 of <u>drawing 10</u> (b), when force other than the oscillating direction is added, since it is formed in plate-like. In addition, in <u>drawing 10</u> (b), a two-dot chain line is the displacement location of the bimorph structure 10 when a twist is not added.

- [0035] <u>Drawing 11</u> (a) shows the case where the parallel flat sheet structure object 1 of this operation gestalt vibrates, and <u>drawing 11</u> (b) is a time of similarly the parallel flat sheet structure object 1 vibrating, and it shows the displacement location of the upper limit of the parallel flat sheet structure object 1 at the time of seeing from the upper part.
- [0036] The location when the location at the time of displacing the mid gear P1 of drawing 11 (b) in the location before displacement, and displacing P2 from a mid gear P1 to one side and P3 displace P2 in the location of another side of the opposite side from a mid gear P1 is shown. In this case, since the parallel flat sheet structure object 1 has rigidity even if force other than the oscillating direction is added, it is not twisted, as it is strong to a twist and is shown in P2 and P3 of drawing 11 (b).
- [0037] In addition, both <u>drawing 10</u> and <u>drawing 11</u> are omitting and illustrating the expedient top of explanation, the electrode layer, and the PZT thin film.
- (3) With this operation gestalt, by the hydrothermal method, the PZT thin film 5 was formed in the both-sides side of base material 4A which has two or more area of the base material 4 of a part, and the electrode layer 6 was formed to the both-sides side of base material 4A after that. Consequently, since the PZT thin film 5 and an electrode layer 6 can be formed to two or more base materials 4 at once, unlike the former, many bimorph structures can be formed at once.
- [0038] (4) With this operation gestalt, by the hydrothermal method, the PZT thin film 5 is formed in the both-sides side of base material 4A, two or more electrode layers 6 are formed after that to the both-sides side of base material 4A in which said PZT thin film 5 was formed, respectively, and if between the electrodes 6 which adjoined mutually is cut, two or more PZT thin film bimorph structures can be obtained.
- [0039] The operation gestalt of this invention can also be changed as follows in addition to the above-mentioned operation gestalt.
- (1) Although considered as the insulating spacer 3, when it forms so that there may be no fear of a short circuit between piezoelectric devices 2, the spacer of non-insulation may constitute from said operation gestalt like a metal spacer. In this case, welding etc. performs fixing over a piezoelectric device 2.
- [0040] (2) In said operation gestalt, although the electrode layer 6 was formed with aluminum, you may form in Au(gold) and may form with other metals.
- (3) Although thickness of an electrode layer 6, the PZT thin film 5, and a base material 4 was made into the predetermined number value with said operation gestalt, respectively, it is not limited to the above-mentioned numeric value, and is good also as numeric values other than the above if needed.
- [0041] (4) Although manufacture of the three bimorph structures was explained, it is not limited to this number and you may make it form two pieces or four things or more at once with said operation gestalt. In addition, it is also possible to manufacture the one bimorph structure, of course.
- [0042] Here, the technical thought grasped according to the operation gestalt mentioned above is listed to below with the effectiveness besides the technical thought indicated by the claim.
- (1) The manufacture approach of the PZT thin film bimorph structure which gave the mask beforehand to the predetermined part of a titanium base material in either claim 3 thru/or claim 5 in front of the process which forms a PZT thin film. It can avoid forming a PZT thin film in the part by which the mask was carried out by carrying out like this. [0043]

[Effect of the Invention] Since according to invention of claim 1 much bimorph structures

can be acquired easily and it becomes a PZT thin film as explained in full detail above, it can be made the small bimorph structure.

[0044] According to invention of claim 2, it can consider as the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form strong against a twist. According to invention of claim 3 thru/or claim 5, much bimorph structures can be obtained at once.

[Translation done.]

#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] (a) and (b) are the sectional view of the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form.

[Drawing 2] The sectional view of a base material.

[Drawing 3] The sectional view of the base material in the condition of having covered with the PZT thin film.

[Drawing 4] The sectional view of the base material in which the electrode layer was formed.

[Drawing 5] The sectional view of the piezoelectric device formed by carrying out pattern NINGU of the electrode layer.

[Drawing 6] Similarly it is the perspective view of a piezoelectric device.

[Drawing 7] The decomposition perspective view showing how an parallel flat sheet structure object should grapple a.

[Drawing 8] The perspective view in the condition of having attached the parallel flat sheet structure object.

[Drawing 9] The perspective view of the parallel flat sheet structure object of a PZT thin film bimorph form.

[Drawing 10] For (a), similarly, the perspective view showing an operation of the single PZT thin film bimorph structure and (b) are an explanatory view.

[Drawing 11] For (a), similarly, the perspective view showing an operation of an parallel flat sheet structure object and (b) are an explanatory view.

[Description of Notations]

1 [-- A base material, 5 / -- A PZT thin film, 6 / -- Electrode layer.] -- An parallel flat sheet structure object, 2 -- A piezoelectric device, 3 -- 4 An insulating spacer, 4A

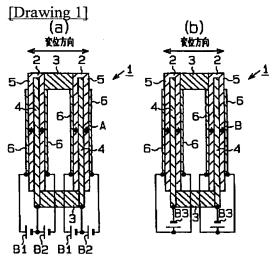
[Translation done.]

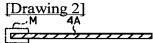
# \* NOTICES \*

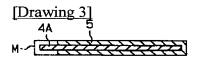
Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

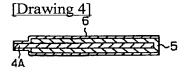
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

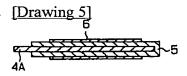
# **DRAWINGS**



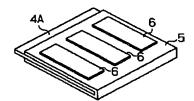


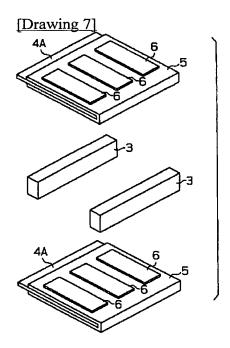


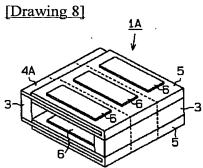


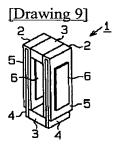


[Drawing 6]

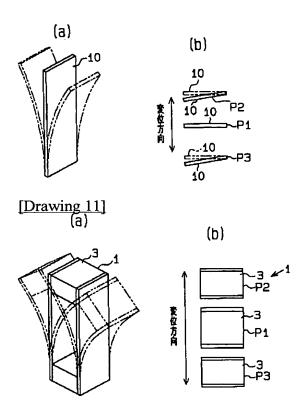








[Drawing 10]



[Translation done.]

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.